

2021 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 K u d a n 株 式 会 社  
代表者名 代 表 取 締 役 C E O 項 大 雨  
(コード番号 4425 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 飯 塚 健  
( T E L . 0 3 - 4 4 0 5 - 1 3 2 5 )

**Kudan Visual SLAM、embedded world 2021 DIGITAL にて  
『embedded award 2021』スタートアップ部門の最優秀賞受賞のお知らせ**

当社は、「embedded world 2021 DIGITAL」のイベントにおいて、日本時間 3 月 3 日（水）21 時 30 分から行われた革新的な製品を対象としたアワード『embedded award 2021』のスタートアップ部門にて、Kudan Visual SLAM<sup>※</sup> (KdVisual) が最優秀賞を受賞しましたことをお知らせいたします。『embedded award 2021』は、あらゆる組み込み系製品から、特に優れて革新的な製品・技術が選ばれる、世界的にも最も権威があり認知度の高いアワードのひとつです。当社は、スタートアップとして最優秀賞を受賞した初めての日本企業となりました。



本アワードの最優秀賞は、革新性の高さ、市場ニーズへのフィット、技術力・競争力の高さ、将来的なスケールの可能性などの観点での審査をもとに決定されました。審査員は、KdVisual をこれらの観点で高く評価したと同時に、グローバルにおいて多くの顧客に既に提供されている点も受賞の要因としてあげられました。

当社の代表取締役 CEO の項大雨は「この度の受賞は、我々の優秀なコンピュータービジョンエンジニアが開発した製品の性能と信頼性を証明するものです。今回の受賞を通過点に、技術革新を加速させ、更なる成長を遂げるとともに、我々の SLAM ソフトウェアを通じて、より良い社会の実現に貢献してまいります」と語っています。

2 万ユーロ相当の提携メディアにおけるマーケティング予算が付与され、これを用いた当社の特集記事などが今後掲載される予定です。

別添資料：最優秀賞の証明書（デジタル版を掲載）

※：SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

センサ情報から周辺環境マッピングと自己位置認識を同時にリアルタイムで行う技術。Kudan では、Lidar とカメラの両方のセンサによる SLAM 技術を保有しており、さらにそれらを組み合わせることで、低レイテンシ・高精度・高安定性をさらに高めることに成功。

「embedded world 2021 DIGITAL」における SLAM 技術のデモ展示に関する詳細

<https://www.kudan.io/jp/archives/572>

### 【K u d a n 株式会社について】

Kudan（東証上場コード：4425）は機械（コンピュータやロボット）の「眼」に相当する人工知覚（AP）のアルゴリズムを専門とする Deep Tech（ディープテック）の研究開発企業です。人工知覚（AP）は、機械の「脳」に相当する人工知能（AI）と対をなして相互補完する Deep Tech として、機械を自律的に機能する方向に進化させるものです。現在、Kudan は高度な技術イノベーションによって幅広い産業にインパクトを与える Deep Tech に特化した独自のマイルストーンモデルに基づいた事業展開を推進しています。

詳細な情報は、Kudan のウェブサイト (<https://www.kudan.io/?lang=ja>) をご参照ください。

#### ■会社概要

会 社 名：K u d a n 株式会社

証券コード：4425

代 表 者：代表取締役 CEO 項 大雨

#### ■問い合わせ先

ir@kudan.eu

# CERTIFICATE

Winner of the



**embeddedaward2021**

Kudan Inc.

Category

Start-up

Product

Kudan Visual SLAM (KdVisual)

---

Nuremberg, 3 March 2021

Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora  
Head of Jury "embedded award"  
Chairman of the  
"embedded world Conference"

Dr. Roland Fleck  
CEO NürnbergMesse Group

Peter Ottmann  
CEO NürnbergMesse Group

**DESIGN &  
ELEKTRONIK**  
KNOW-HOW FÜR ENTWICKLER

**NÜRNBERG MESSE**